

国泰君安证券股份有限公司
关于陕西源杰半导体科技股份有限公司
2024 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“源杰科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责源杰科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与源杰科技签订了《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	源杰科技在 2024 年上半年未发生按相关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	源杰科技在 2024 年上半年未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所	2024 年上半年，保荐机构督导源杰科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规

序号	工作内容	持续督导情况
	发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促源杰科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	报告期内，公司存在使用募集资金建设项目铺底流动资金支付与该建设项目无关的总公司行政管理人员及销售员工资的情况。公司已做相应整改，并按照内部审批流程将上述资金归还至募投项目的专项资金账户，详见本报告“二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况”。报告期内，保荐机构持续督导源杰科技根据相关法规要求，建立健全并执行相关内控制度
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促源杰科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	公司因收入跨期确认存在定期报告信息披露不准确的情形，已做相应整改，详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露的《关于陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2024-057）
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2024年上半年，源杰科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项

序号	工作内容	持续督导情况
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2024年上半年，源杰科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清，上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2024年上半年，源杰科技不存在前述应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2024年上半年，源杰科技未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐人、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项	2024年上半年，源杰科技不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2023年7-12月以及2024年1-4月，公司分别使用10G、25G光芯片产线建设项目铺底流动资金支付与该建设项目无关的总公司行政管理人员及销售人员工资303.74万元、198.03万元。不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第六条规定。

整改措施:

在资金使用范围方面,公司对于前述的铺底流动资金的使用理解因经验不足存在一定偏差,从而导致在“10G、25G 光芯片产线建设项目”的铺底流动资金的使用中存在不规范。具体整改措施如下:

1、2024年5月开始,公司停止将“10G、25G 光芯片产线建设项目”中的“铺底流动资金”用于同生产和建设无关的项目支出。

2、针对已将“10G、25G 光芯片产线建设项目”募投项目中的“铺底流动资金”用于同建设项目无关的金额(501.77万元),公司已按照内部审批流程将上述资金归还至募投项目的专项资金账户。

3、针对公司实际控制人、董事、财务总监、财务部和证券部员工,加强募集资金相关制度和案例的学习和培训,进一步深入理解募集资金使用规则。对于日常事项,尤其是新业务,同监管机构、中介机构等专业人士加强沟通,以防止规则理解偏差所导致不规范情形的发生。

截至本报告出具日,公司已完成上述事项的整改。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下:

(一) 核心竞争力风险

1、技术升级迭代的风险

随着全球光通信技术的不断发展,技术革新及产品升级迭代加速,应用领域不断拓展已成为行业发展趋势。光芯片公司也需要紧跟光通信产业的发展趋势,不断进行光芯片设计优化及生产工艺改进,以技术先进且富有竞争力的产品满足通信系统及光模块产品日益提升的对速率、集成度等方面的要求。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场,将导致公司的产品研发能力和生产工艺要求不能适应客户与时俱进的迭代需要,逐渐丧失市场竞争力,对公司未来经营业绩造成不利影响。

2、新产品研发及商业化失败风险

公司的主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，需集聚设计、研发、生产等公司多部门的技术人员相互配合，同时试制的激光器芯片产品还需要经过下游客户的严格认证，因此新产品研发及商业化具有投入大、周期长、风险高的特点。未来公司研发的新产品若因成本高、可靠性弱、性能达不到下游客户需求、无法大规模量产等因素，进而导致公司新产品无法顺利通过下游客户的认证或大批量出货，则将会对公司的经营业绩造成不利影响。目前公司主要高端产品中，CW光源 70mW 产品已经在部分客户通过测试。100G PAM4 EML 光芯片目前正在客户端送样测试。200G PAM4 EML 处于产品研发阶段，初步完成性能研发及厂内测试，正持续优化中。相关产品的研发进度、客户端测试进展、大规模量产的产能爬坡进度等存在不确定性。

3、核心人才流失和技术泄密风险

光芯片行业涵盖设计、工艺等多个核心领域，光芯片制造不仅需要精通设计的技术人员，更需要经验丰富的生产工艺人员，因此公司需要不断引进和培养优秀的技术、工艺人才，并对核心员工实施股权激励，维持核心人才团队的稳定。随着市场需求的不断增长和行业竞争日益激烈，如果公司不能持续加强核心人员的引进、培养、激励和保护力度，则未来可能出现核心人员流失和技术泄密，从而对公司的生产经营产生不利影响。

作为国内为数不多可以自主完成外延片设计开发与规模化生产的企业之一，产品复杂的工艺流程更需要优秀、专业、与公司共同发展的人才，公司一如既往的重视核心技术人才的引入留用、激励机制及个人发展的有效执行。产品的技术创新、稳定的生产经营离不开强大的专业技术团队，公司持续将员工及公司的发展紧密结合，稳定关键人才团队，规避核心技术人员的流失风险。

保护技术是保护公司的竞争力，公司对相关人员签订保密协议并定期进行培训教育，同时，通过对敏感信息访问权限制、文件发送渠道授权、技术文件加密、重要数据定期备份等加强网络安全管理；通过严格管理最大限度预防技术泄密，降低泄密风险。如技术人员违反保密规定将技术信息向外部泄露，可能会对公司的市场竞争力等带来不利影响。

（二）经营风险

1、部分下游厂商与公司存在潜在竞争关系的风险

光芯片具有技术壁垒高、工艺流程复杂、产品种类繁多且升级迭代较快的特点，因而毛利率水平整体高于产业链下游厂商，并且光芯片在光模块成本中的占比很高。部分下游厂商如海信宽带、光迅科技等，出于成本控制、产业链延拓、供应链安全等方面的考虑，积极进行整合并研发自有芯片，部分产品一定程度上与公司存在潜在竞争关系。未来如果公司不能持续推出符合市场需求的高速率产品及具有差异化优势的中低速率产品，将可能造成公司订单数量的减少，并导致公司面临更加激烈的市场竞争。

2、产品质量控制风险

公司的激光器芯片产品生产工序较多，产品工艺较复杂，随着产品迭代加快，对公司的生产工艺以及员工的生产经验都提出更高的要求，公司对质量控制的难度相应加大。行业重要客户对产品的批次质量、稳定可靠性等均有严格要求，需要公司建立适宜、有效、充分的质量管理体系。随着公司业务规模的持续增长，产品持续进行升级和迭代，以及客户对产品品质要求的不断提高，不排除由于某些不可预见的因素导致产品出现瑕疵，若产品出现严重的缺陷或质量问题，公司声誉将会受到影响，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

3、毛利率波动及业绩可持续性风险

公司产品目前主要应用于光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心等领域，具有产品不断迭代升级的特点。随着市场竞争加剧，细分产品单价下降对公司的整体毛利率产生一定影响。报告期公司的综合毛利率为 33.42%，若公司未来产品价格持续下降，而公司未能采取有效措施，无法巩固产品的市场竞争力或在高端市场持续突破，未能契合市场需求率先推出新产品，则将会对公司的经营业绩造成不利影响，公司当前毛利率水平的可持续性也将受到影响。在下游应用领域方面，公司目前的收入结构中光纤接入领域占比仍较高，该市场以 2.5G 和 10G 速率产品为主，市场竞争较为激烈。而数据中心等高毛利产品领域中的产品收入占比仍相对较低。若上述收入结构未能改善，公司毛利率和业绩提升也将受到不利影响。同时公司在生产过程中还将面临人力成本、固定资产投资、能源成本等各方面因素影响，从而使得公司面临毛利率和经营业绩波动的风险。

（三）财务风险

1、存货跌价风险

报告期内，虽然存货周转率同比有所改善，但公司的存货水平仍有小幅增加。若未来市场竞争加剧，公司主要产品的价格未来出现大幅下滑，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，将出现较大存货跌价风险。此外，为了兼顾产能利用率水平，公司对于主力产品的备货量有所增加。未来若下游的技术和市场应用出现重大不利变化，市场需求大幅下滑或公司市场开拓不及预期，也将使得存货可变现净值低于成本，出现较大的存货跌价风险。

2、应收账款减值风险

报告期内，公司应收账款呈现上升趋势，主要系公司收入规模上升所致，同时，因市场环境竞争加剧，部分客户出现一定的逾期款项。虽然公司已采用有效的应对措施，但若宏观经济形势、行业市场波动、客户财务状况或资信情况发生重大不利变化，或公司应收账款管理不当，公司可能面临应收账款存在无法收回并相应计提坏账的风险。

（四）行业风险

公司产品主要应用于光通信领域，而光芯片行业作为光通信产业链的上游，其需求易受下游电信市场及数据中心市场发展态势的影响。如果未来下游市场需求不及预期，出现需求大幅减弱甚至持续低迷的不利情形，将导致公司未来经营业绩存在波动的风险。未来若数据中心市场发展不及预期、国产化替代进程受阻、数据中心领域产品迭代速度加快或行业竞争加剧，公司在数据中心市场的销售收入将受到较大影响。

（五）宏观环境风险

近年来，国际贸易摩擦特别是中美贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护等手段，试图制约我国半导体产业的快速发展。衬底是公司生产激光器芯片产品的主要原材料之一，但目前大规格、高品质衬底基本为境外厂商垄断。虽然公司从国内采购的衬底比重逐渐提高，但是来自境外厂商的衬底仍然占有一定的比重。此外，公司生产激光器芯片产品所需的部分设备亦来自境外厂商。国际局势瞬息

万变，一旦因国际贸易摩擦进一步加剧，导致部分供应商未能及时甚至无法供货或提供设备，公司的正常生产经营将受到重大不利影响。

四、重大违规事项

2024年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年上半年，公司主要财务数据及指标具体如下所示：

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本期比上年同期增减
营业收入	12,015.89	6,131.91	95.96%
归属于上市公司股东的净利润	1,075.13	1,939.11	-44.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	947.02	411.80	129.97%
经营活动产生的现金流量净额	1,284.72	-2,861.87	不适用
	本报告期末	上年度末	本期比上年度末增减
归属于上市公司股东的净资产	209,193.19	211,668.78	-1.17%
总资产	218,111.44	223,668.23	-2.48%

（二）主要财务指标

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.13	0.32	-59.38%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.32	-59.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
加权平均净资产收益率（%）	0.50	0.91	减少 0.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.44	0.19	增加 0.25 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	18.35	21.52	减少 3.17 个百分点

（三）主要财务数据及指标的变动原因

1、本报告期营业收入同比上升 95.96%，主要系光芯片行业较 2023 年半年度有一定恢复，虽然中低速率产品市场竞争压力仍较大，但随着产品线进一步丰富，总体收入同比有所增加；

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降 44.56%，主要系报告期收到政府补助同比大幅减少所致；

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 129.97%，主要系收入增加导致利润同步增加及销售产品结构变化所致；

4、基本每股收益、稀释每股收益同比下降 59.38%，主要系报告期净利润下降及股本增加所致；扣除非经常性损益后的基本每股收益同比上升 57.14%，主要系股本增加及报告期确认其他收益、公允价值变动收益及投资收益等非经常性损益较上年同期减少较多所致；

5、加权平均净资产收益率同比减少 0.41 个百分点，主要系报告期利润减少所致；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加 0.25 个百分点，主要系本期确认其他收益、公允价值变动收益及投资收益等非经常性损益较上年同期减少较多所致；

6、研发投入占营业收入的比例同比减少 3.17 个百分点，主要系报告期收入同比增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）技术积累与研发优势

公司是光芯片领域的高新技术企业。光芯片行业具有较高的技术壁垒，产品的迭代更新需要深厚的芯片设计经验和制造工艺经验，迭代过程中需要对芯片结构、材料特性、制造工艺、生产设备等开展大量创新性的工作，才能够保证良好的产品特性及可靠性。公司自成立以来一直致力于光芯片的研发、设计、生产与销售，自主打造晶圆生产线，购置配套专业生产设备，培养专业人才。经过长期研发投入积累一系列核心技术。同时，公司持续增加研发投入，在现有研发积累

的基础上，通过扩大升级研发实验室、材料科学实验室，优化研发环境及引进一批先进的研发、生产、检测设备和专业技术人才，提升整体研发能力。公司以市场发展的趋势为导向，及时调整原产品迭代升级与新产品的技术预研方向，使产品持续跟随市场面向趋势。

在研发管理方面，公司将不断完善研发激励机制，对在产品的技术研发、参数改进、专利申请等方面做出贡献的技术研发人员均给予相应的奖励，激发技术研发人员的工作热情。公司建立了多层次的研发体系，培养了大批基础扎实、技术一流的芯片设计及制造的工程技术人员，同时不断吸纳高质量人才的加入，不断提升技术团队的自主创新能力和技术水平。

（二）客户资源优势

公司的光芯片产品的特性、可靠性、批量供货能力经过了下游客户的长期验证，得到了客户的高度认可。公司已在市场上树立了质量可靠、服务完善的良好品牌形象。同时也在境内外市场开拓了众多的直接或间接优质客户。光芯片产品在下游客户的导入需经过较长的验证过程，公司率先进入了国内外客户的供应体系，建立了较高的客户资源壁垒，为公司的持续发展建立了良好的市场基础。

（三）产品结构优势

公司产品广泛应用于光纤接入、移动通信、数据中心、车载激光雷达等领域。下游不同场景、不同客户对光芯片产品的性能指标有诸多差异化需求。公司目前产品包括 2.5G、10G、25G、50G、100G 光芯片产品、CW 光源、车载激光雷达光源等产品，多元化的产品体系可以发掘更多市场需求，更好的满足客户需求，打开更广阔的市场空间。

（四）人才团队优势

公司在光芯片领域的多年深耕，建立了高素质专业人才团队，积累了一批优秀的以研发人才、技术人才、管理人才为核心的团队成员。同时公司构建了一批高层次人才队伍，包括多名陕西省西安市高层次人才认定的国家级领军人才、地方级领军人才，西安市西咸新区认定的科研创新人才以及西安市认定的地区优秀人才和实用储备人才。

公司重视产学研结合，与本地高等学府建立合作，签订技术合作协议，推进芯片技术的深入研究。同时，公司特聘西安市多所知名高校教授进行专题讲座，为技术骨干员工打造技术交流平台，探讨学习，持续赋能，并不断提升个人专业知识能力，为公司的技术实力打下坚实基础。

（五）生产制造优势

公司十年来积累了丰富的生产管理经验和较强的产品质量控制能力，并形成了一定的产业规模，在生产方面具有一定的技术先发优势与规模优势。公司生产设备已具备大功率激光器、DFB 激光器、EML 激光器等产品的生产制造能力，并且多数设备可以实现不同产品生产制造即时切换，实现互相备份，充分保证和响应客户的不同需求生产交付。在晶圆生产方面，公司通过工艺优化，不断提高单片产出数量，提升生产效率。在生产过程方面，公司加大信息化管理程度，更有效的监控生产过程的稳定性，防呆防错，并且实现生产过程的可追溯性，充分保证产品质量。总体来看，公司的产能规模、能力及效率将有望进一步提升，巩固公司市场地位及竞争能力。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2024 年上半年，公司研发支出为 2,205.20 万元，较去年同期增长 67.12%，占营业收入的比例为 18.35%。

（二）研发进展

公司加大了高速率光芯片及大功率光芯片等产品的相关技术和设备投入。光纤接入领域，公司进一步优化原有产品，并积极开展下一代 25G/50G PON 光纤网络 ONU 及 OLT 端光芯片产品的研发及测试工作。数据中心领域，由于人工智能技术的发展，极大的拉动了 100G PAM4 EML、CW 光源等高端芯片的需求，公司相关产品已经完成研发与设计定型，正在配合客户进行产品测试。报告期内，公司 CW 产品在部分客户测试通过并开始批量交付。在更高速率的应用场景，公司初步完成 200G PAM4 EML 的性能研发及厂内测试，正持续优化中。在高速产品高频性能验证方面，通过高端人才和设备的投入，公司着力加强高速基板的性

能仿真、更高速的带宽、眼图测试系统，可以快速进行芯片级的性能评估验证，配合高速芯片的研发迭代。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额（含发行费用）	150,990.00
减：发行费用（不含增值税）	13,122.27
扣除发行费后募集资金净额	137,867.73
减：募集资金累计使用金额（包括实际已置换先期投入金额）	76,809.60
加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额	2,567.00
尚未使用的募集资金金额	63,625.13
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	48,510.10
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额	15,115.03

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	账户类型	账号	余额
中信银行西安分行营业部	募集资金专户	8111701012300735584	1,316.91
兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	募集资金账户	456640100100067850	4,027.79
兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	募集资金账户	456640100100067732	3,263.71
招商银行股份有限公司咸阳分行	募集资金账户 （已注销）	910900263110222	-
招商银行股份有限公司咸阳分行	募集资金账户	910900263110330	6,506.62
合计			15,115.03

报告期内，公司存在使用 10G、25G 光芯片产线建设项目铺底流动资金支付与该建设项目无关的总公司行政管理人员及销售人员工资的情况。公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《行政监管措施决定书》（陕

证监措施字〔2024〕30号)。具体详见公司2024年8月3日于上海证券交易所网站披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于收到陕西证监局行政监管措施决定书公告》(公告编号:2024-049)。公司已做相应整改,并按照内部审批流程将上述资金归还至募投项目的专项资金账户。

除此之外,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2024年6月30日,公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股变动情况如下:

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
程硕	董事、副总经理、董事会秘书	126,000	220,500	94,500	2021年股票期权激励计划第二个行权期行权
潘彦廷	董事(离任)、副总经理、核心技术人员	44,800	78,400	33,600	2021年股票期权激励计划第二个行权期行权
陈文君	副总经理	126,000	220,500	94,500	2021年股票期权激励计划第二个行权期行权
陈振华	副总经理、财务总监	126,000	220,500	94,500	2021年股票期权激励计划第二个行权期行权

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王兴	核心技术人员	11,200	19,600	8,400	2021年股票期权激励计划第二个行权期行权
王永惠	董事（离任）	5,600	9,800	4,200	2021年股票期权激励计划第二个行权期行权

截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

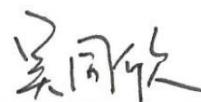
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：



李 冬



吴同欣

国泰君安证券股份有限公司

